



**Soitec et l'Agence de l'Innovation Industrielle annoncent l'autorisation
de la Commission Européenne du financement du programme stratégique
de recherche-développement (R&D), *NanoSmart***

Bernin, France – le 13 septembre 2007

Soitec, (Euronext, Paris), le premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et autres substrats innovants, et l'Agence de l'Innovation Industrielle (AII) annoncent l'autorisation de la Commission Européenne du financement du programme stratégique de recherche-développement NanoSmart. Le coût total du programme pour l'ensemble des partenaires s'élève à 200 millions échelonnés sur cinq ans. L'aide publique accordée au Groupe Soitec est de 62 millions d'euros, composée d'une subvention directe de 34 millions et d'une partie d'avance remboursable de 28 millions en fonction du succès commercial du programme.

Le projet pluriannuel ambitieux de R&D associe Soitec, basée à Bernin (région grenobloise), sa filiale Picogiga, basée aux Ulis (sud de Paris) et le *Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information* issu du *Commissariat de l'Energie Atomique* (CEA-Léti). Ce programme *NanoSmart*, stratégique pour l'Europe, vise le développement de substrats avancés pour les composants microélectroniques et optoélectroniques. Il met en avant le rayonnement de la France dans l'innovation sur l'ingénierie des substrats semi-conducteurs mais aussi celui de Bernin et du pôle de compétitivité *Minalogic* à Grenoble.

La plate-forme de recherche *NanoSmart*, qui relève du domaine des **nanotechnologies**, entend développer une nouvelle génération de matériaux avancés pour améliorer les performances et la consommation électrique des processeurs de traitement d'image, des composants haute fréquence pour télécommunications, des composants de puissance pour l'automobile et l'audiovisuel domestique, et des diodes électroluminescentes pour l'éclairage.

« Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui l'accord de la Commission Européenne pour ce programme ambitieux et stratégique, non seulement pour Soitec, mais aussi pour la France et l'Europe tout entière. Les substrats avancés sont une opportunité unique de renforcer la position européenne dans l'industrie de haute technologie où la compétitivité est basée sur l'innovation », déclare André-Jacques Auberton-Hervé, Président Directeur Général de Soitec. « Nous remercions l'AII pour son soutien et pour sa politique d'aide à l'innovation mise en place en direction de sociétés de notre taille aux côtés des grands groupes industriels français. »

L'AII a souhaité aider Soitec dans son nouveau cycle d'innovation sur des ruptures technologiques fortes qui préparent les marchés de demain, mais aussi de porter cette entreprise française industrielle de croissance au rang des leaders mondiaux du secteur des substrats, démarche au cœur de la mission de l'AII dans son soutien à l'industrie par l'innovation et par une politique de grands projets.

Ce programme fait partie intégrante du plan stratégique de développement du groupe Soitec pour les années 2006-2010, annoncé le 6 juillet 2006. Sur cette période, Soitec entend renforcer ses activités R&D sur le site de Bernin pour asseoir les bases du programme *NanoSmart* au plus près des équipes de production pour le déploiement industriel.

Ce partenariat facilitera et contribuera à la diffusion des connaissances dans les domaines des nanotechnologies, non seulement au niveau de la recherche européenne mais également mondiale.

À propos du Groupe Soitec :

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.



Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production actuellement en construction à Singapour.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions et l'obligation convertible du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

###

Pour toute information, contacter :

Relations Presse – H & B Communication

Marie-Caroline Saro – Anne Hardy – Tel. 33 (0)1 58 18 32 44

Email : mc.saro@hbcommunication.fr

Soitec

Camille Darnaud-Dufour - Directrice de la Communication – Tel. 33 (0)6 79 49 51 43

Email : camille.darnaud-dufour@soitec.com